



半导体行业周报：三季度全球 半导体设备出货金额续创新高 芯导科技上市



IPO 进度:东芯股份于 11/30 申购,定价 30.18 元/股。截至 2021/12/5, 共有 131 家半导体企业申报 IPO、开展上市辅导等,东芯股份已完成申购即将上市,思科瑞已过会,比亚迪半导体、新汇成、海光信息进入问询阶段,耐科装备、振华风光、蓝箭电子进入已申报阶段。

功率半导体:芯导科技专注于高品质、高性能功率 IC 和功率器件的开发及销售,捷捷微电研发的第三代半导体材料的半导体器件有少量碳化硅器件的封测,国星光电建立功率器件试产线。芯导科技始终聚焦于功率器件和功率 IC,是国内 TVS、MOSFET 等功率器件产品技术领先企业,功率 IC 核心产品也已通过诸多如小米、TCL、传音等品牌客户以及华勤、闻泰、龙旗等 ODM 客户的验证。芯导科技业绩高速增长,2021 年前三季度营收 3.68 亿元,同比增长 44.34%;净利润 9189.7 万元,同比增长 75.3%。公司产品已覆盖消费类电子、网络通讯、安防、工业等领域。捷捷微电 12 月 1 日表示,公司与中科院微电子研究所、西安电子科大合作研发的以 SiC、GaN 为代表第三代半导体材料的半导体器件,目前有少量碳化硅器件的封测,系列产品仍在持续研究推进中。国星光电 12 月 3 日表示,公司本部建立了功率器件试产线。目前正在积极布局第三代半导体氮化镓功率器件的外延开发。

半导体材料:光微半导体 3nm 超纯溅射靶材产业化项目已投入试生产。光微半导体材料(宁波)投资的国产 3nm 超纯溅射靶材产业化项目已投入试生产。产品正处于客户验证阶段,预计近期可实现量产,靶材产品明年初可投入试生产。

半导体设备:三季度全球半导体设备出货金额达 268 亿美元,同比增长 38%。12 月 2 日,SEMI 发布报告指出,2021 年第三季度全球半导体制造设备出货金额达 268 亿美元,同比增长 38%,环比增长 8%,连续五个季度创历史新高。按区域划分,三季度,台积电、联电、世界先进、力积电等公司持续投入资本支出,中国台湾地区的半导体制造及设备出货金额达到 73.3 亿美元,季度环比增长 45%,同比增长 54%,使中国台湾地区在第三季度成为全球最大市场。同时,中国大陆地区三季度半导体设备出货金额为 72.7 亿美元,位列全球第二。

晶圆代工/芯片制造:振华风光拟科创板 IPO 重建晶圆制造产线,第三季度圆代工产值高达 272.8 亿美元,季增 11.8%。振华风光科创板 IPO 获受理,从募投项目来看,振华风光力求补齐晶圆制造环节,成为一家 IDM 厂商。振华风光拟重建晶圆制造产线,拟公开募资 12 亿元,其中 80%募集资金将投于集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目。根据 TrendForce 集邦咨询调查显示,随着晶圆代工厂新增产能放量,以及平均售价持续上涨,第三季晶圆代工产值高达 272.8 亿美元,季增 11.8%,已连续九个季度创下历史新高。

汽车芯片:上汽集团斥资 5 亿完成对积塔半导体 A 轮投资。11 月 30 日,上汽集团携旗下投资平台尚颀资本共同出资 5 亿元,完成对国内领先车规级芯片及碳化硅功率器件生产企业上海积塔半导体有限公司的 A 轮投资。本轮融资将加大积塔半导体在车规级电源管理芯片、IGBT 和碳化硅功率器件等产品的研发力度,提升与车企的融合速度。投资建议:

设备组合:盛美上海、中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、精测电子、万业企业、长川科技、迈为股份;建议关注:晶盛机电、光力科技、神工股份

材料组合建议关注:沪硅产业、雅克科技、安集科技、立昂微、彤程新材、晶瑞电材、中环股份、鼎龙股份

功率半导体组合:新洁能、华润微;建议关注:斯达半导、士兰微、闻泰科技

模拟建议关注:圣邦股份、思瑞浦、卓胜微(射频)

MCU:兆易创新;建议关注中颖电子

其他:韦尔股份;建议关注:三安光电、乐鑫科技、恒玄科技风险提示

疫情影响超预期;半导体设备国产化进程放缓;半导体材料国内市场增速放缓;美国进一步向中国禁售关键半导体设备。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_30595

